

2015年2月20日

各位殿

NPO 法人 3G シールドアライアンス
(3月 NPO 法人オープンワイヤレスアライアンスに)
代表理事 高本孝頼

「第3回ワイヤレス M2M/IoT システム・アイデア・コンテスト」ご協賛のお願い

当アライアンスはオープンソースベースのワイヤレスを使って、誰もが簡単に短時間にモノづくりできる環境を提供することで、最新で高度な技術の教育さらに雇用の創出を目指し、さらに日本での新たな M2M/IoT システムの試作・プロトタイプ開発・量産化を促進することを目指しています。

これからの 10 年は M2M/IoT の時代と言われ、いろいろな分野において急成長が期待されています。しかしながら、センサ技術やワイヤレス技術、それにインターネット技術など、高度でスキルの高い技術習得や多岐に渡る技術の組合せは、若い技術者の障壁になっていました。当アライアンスではこの障壁を取り除くための工夫をもって、様々な活動を展開してきました。

今回の「アイデア・コンテスト」もそのひとつで、今年で第3回目を迎えます。

このコンテストでは、多くのチャンスが存在する M2M/IoT 分野において、最先端の技術を習得し、組合せ、さらに新たな知恵を出しあい、斬新なモノづくりを具現化する場面や環境を提供するものです。

すでに第1回(2013年)、第2回(2014年)と「3Gシールド・アイデア・コンテスト」の名称で3GシールドをベースとしたM2Mシステムのアイデアと開発を競ってきました。今年の第3回はハードウェアとして3Gシールド+Arduinoだけでなく、以下のワイヤレスボード、また最新のCPUボードも応募対象にいたします。

ワイヤレスボード：3Gシールド、3GIM、PHSシールド、各種無線LAN

CPUボード：Arduino、GR-SAKURA、Galileo、Edison、ARMコアMBED、Raspberry Pi

開発プラットフォームが大幅に拡充に伴い発想の幅が広がり、画期的なアプリケーションの多様化に伴い応募者がさらに多くなると期待しています。

第1回、第2回に引き続き何卒ご協賛を賜りますようお願いいたします。

協賛費(税別)

	ご協賛費	審査員	メーカ賞	公告・パンフ掲載
プラチナ	50万円	○	○	○
ゴールド	30万円		○	○
シルバー(中小企業)	10万円			○

* 審査員は全応募者の作品(説明書類および3~5分のビデオ)をレビューできます。

* メーカ賞はご協賛会社製品を採用した応募作品から選んでいただくことができます。メーカ賞の賞金は上記協賛金の一部を充当します。

* ご協賛費を会場費、応募者景品、入賞者賞金・副賞及び諸経費になります。

* ご協賛企業には応募者への景品(副賞)にする品(販促グッズ他)のご提供いただく

コンテスト概要

作品募集 1次：アイデアを募集、ペーパー審査で入賞者に機材貸出（グループ応募可）

募集期間 2015/5~7月 => 審査 7月末

2次：上記アイデアを実装したシステムを募集（1次応募なしでの応募も可能）

募集期間 ~9月末 => 審査発表 10月（発表会開催時）

予定応募者数：1次 100件、2次 50件

審査発表会参加予定数：200名（セミナー、展示会併設）

主催：NPO法人 3G シールドアライアンス

共催：日刊工業新聞（昨年に引き続き共催をお引き受け頂いています）

後援団体予定：新世代 M2M コンソーシアム、MCPC M2M 部会、情報処理学会等

審査委員の先生方（昨年度）：萩谷 昌己 先生 [東京大学教授]、笈 捷彦 先生 [早稲田大学教授]、
汐月 哲夫 先生 [東京電機大学教授]、林 誠治 先生 [拓殖大学准教授]、鈴木 誠 先生 [東京大学助教]
天良 和男 先生 [東京都立小石川中等教育学校 教員]

応募作品募集概要

応募システム条件：ワイヤレスベースの IoT/M2M システム（基本構成はセンサ端末、{無線 LAN}、
広域通信 3G または PHS、クラウド）

* {無線 LAN} 第3回から新たに加わった要素で必須ではない

応募基本ハードウェア

CPU ボード：Arduino、GR-SAKURA、Galileo、Edison、MBED、Raspberry Pi 他

広域通信ボード：3G シールド、3GIM、PHS シールド

無線 LAN：Wi-Fi、Bluetooth LE、Wi-SUN、EnOcean、Dust Network 他

* 上記基本ハードウェアを使用してシステム開発際に必要なサンプルプログラムはクラウド
(Xivory) も含め当アライアンスでテキストとして用意

応募資格：誰でも可、しかし学生・生徒歓迎（昨年度の最優秀賞は中学1年生が獲得）

募集期間：第1次 5月~7月 アイデアを報告書形式で提出

第2次 ~9月末 IoT/M2M システムを開発、動作状態をビデオで提出

審査発表：第1次 8月初 全応募者に粗品進呈、応募者には基本ハードウェア貸出

第2次審査発表会：10月末予定 全応募者に粗品、

入賞者以上の応募者に次ページの通り賞状・賞金・副賞

発表会にセミナー、展示（協賛企業、入賞者）を併設

予定会場：早稲田大学 西早稲田キャンパス

予定審査員：東京大学教授 萩谷昌己先生（委員長）、同助教 落合秀也先生、

情報科学芸術大学院大学 准教授小林茂先生、東京大学同助教鈴木誠先生、

東京都立小石川中等教育学校 教諭 天良和男先生、ご協賛企業

第1回（2013年）、第2回（2014年）の実績

	第1次応募者数	第2次応募者数	発表会来場者数	協賛企業数
第1回(2013年)	52	22	197名	9社
第2回(2014年)	50	11	105名	10社

2014 年第 2 回コンテスト協賛企業

IIJ（インターネットイニシアチブ）、インテル、インフォコーパス、エイビット、スイッチサイエンス、タブレイン、フタバ企画、マイクロウェーブファクトリー、ルネサス、ローム

表彰

最優秀作品賞	入賞・メーカー賞から 1 名	賞状、賞金 10 万円
優秀賞	入賞・メーカー賞から 2 名	賞状、賞金 5 万円
メーカー賞	各メーカー賞	賞状、賞金 7 万円
上記以外の入選・メーカー入選全員		賞状、賞金 1 万円

* 関東地方以外の入選者が審査発表会参加の際は東京までの交通費実費を支給

メーカー賞：賞設定初回なので、詳細はご意見をいただきながら微調整の予定

プラチナ・ゴールドご協賛いただいたメーカーの選んだ作品に授与

* 1 次応募(7 月末)で制作作品の仕様と共に使用機器を明記、各メーカー賞ご協賛企業の製品を使用する応募者に貸与（作品を制作し 2 次応募者には贈与）または贈与いただく

* 2 次応募からメーカー賞を選ぶプロセス案

1. メーカー賞ご協賛企業製品使用の応募作品のビデオからご協賛企業が 2 又は 3 件選ぶ
2. 10 月末の審査発表会で、入選作品同様プレゼン・実機展示、審査で 1 名を選ぶ

* メーカー賞サポート

1. 当アライアンスホームページに各メーカー賞ご協賛企業のページを作成。製品概要紹介・Q&A コーナー及び各ご協賛企業のテクニカルページや Q&A ページへリンク
2. Q&A コーナーは当アライアンスだけでなく覚悟協賛企業のご協力に対応
3. ご協賛企業で技術トレーニング等のご計画があれば、当アライアンスも後援・共催

第3回「ワイヤレス IoT/M2M コンテスト」協賛申込書

■ 申込年月日	2015年 月 日		
■ 会社(団体)名			
■ 住所	〒		
	TEL:	FAX:	
	URL http://		
	公式 Web サイトからのリンク <input type="checkbox"/> 希望する <input type="checkbox"/> 希望しない [<input type="checkbox"/> にレ点をご記入ください。]		
■ 申込ご担当者	部署名:		
	フリガナ		
	氏名:	Ⓔ	
	E-mail:	@	
■ 協賛種別	[<input type="checkbox"/> にレ点をご記入ください。] 協賛料 <input type="checkbox"/> プラチナ: 500,000 円 (税別) <input type="checkbox"/> ゴールド: 300,000 円 (税別) <input type="checkbox"/> シルバー: 100,000 円 (税別)		
■ 発表会展示	展示製品をご記入ください。		
■ 事務局記入欄	受付日	担当	受付番号

送付先: NPO 法人 3G シールドアライアンス

〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷 3-5-7-301

FAX03-6411-5753 電話番号 03-6411-5705

Email: info@3gsa.org

申込方法: 郵送、ファックスまたは email でファイル送信